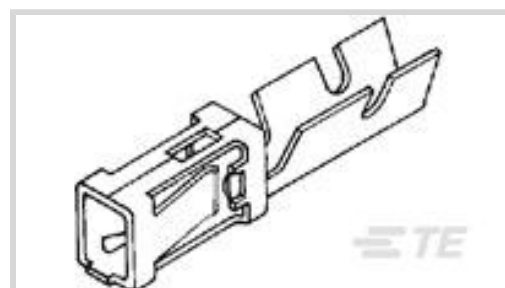




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **锡**

线径: .3 – .9 mm<sup>2</sup>

端子基材: **磷青铜**

## 产品特性

### 产品类型特性

施加的压力	高
-------	---

### 电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

接触电阻	12 mΩ
------	-------

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.4064 μm[16 μin]
------------------	------------------

端子接合区域电镀材料厚度	.4064 μm[16 μin]
--------------	------------------

端子方向	直式
------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子类型	插座
------	----

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流 (最大值)	5 A
--------------	-----

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

## 尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.3 – 2.29 mm [.051 – .09 in]
线径	.3 – .9 mm <sup>2</sup>

## 使用环境

工作温度范围	-65 – 60 °C [-85 – 140 °F]
--------	----------------------------

## 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

## 包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[MOD I RECP LP](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION\\_6\\_7AND8](#)

英文版本



---

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**AMPMODU Mod I Receptacle Crimp Contact**

英文版本

---

**使用说明书**

**使用说明书 (美国)**

英文版本